

附件 1

集成电路类项目概述 (2009-2010 年)

1、项目名称: 高性能服务器多核 CPU

项目编号: 011

项目目标: 面向国产高性能服务器和高性能计算机的国产多核 CPU 及配套的外围芯片、基础软件、样机系统, 应用于国产千万亿次高性能计算机。

组织实施方式: 定向委托或择优委托

执行期限: 2009-2010 年

项目资金与配套资金比例: 1:1

2、项目名称: 安全适用计算机 CPU

项目编号: 012

项目目标: 自主指令系统或得到合法授权国际主流/流行指令系统兼容的国产 CPU 产品; 采用该 CPU 研制低成本、易维护、安全适用计算机, 并在“十一五”期间达到百万台以上应用规模。

组织实施方式: 定向委托或择优委托

执行期限: 2009-2010 年

项目资金与配套资金比例: 1:1

3、项目名称: 高性能嵌入式 CPU

项目编号: 013

项目目标: 面向媒体处理、网络和通信等应用的可配置、高性能、低功耗嵌入式 CPU 及其配套软硬件开发环境; 在“十一五”期间形成 3000 万片以上采用该类 CPU 核的 SoC 规模应用。

组织实施方式：定向委托或择优委托

执行期限：2009-2010 年

项目资金与配套资金比例： 3:2

4、项目名称：个人移动信息终端 SoC 芯片

项目编号：004

项目目标：面向移动通信、数据处理、多媒体处理和多模卫星导航等个人移动信息终端的 SoC 产品，具有丰富外设接口、超强信息处理能力和超低功耗。“十一五”期间该类芯片达到千万片级的规模应用。

组织实施方式：定向委托或择优委托

执行期限：2009-2010 年

项目资金与配套资金比例： 1:3

5、项目名称：存储控制 SoC 与移动存储芯片

项目编号：005

项目目标：面向移动信息处理设备或终端的 GB 级低功耗、非挥发存储 (NVM) 芯片，以及高性能、强容错和安全的存储控制 SoC 芯片产品。“十一五”期间达到百万片级的规模应用。

组织实施方式：定向委托或择优委托

执行期限：2009-2010 年

项目资金与配套资金比例： 1:4

6、项目名称：数字电视 SoC 芯片

项目编号：006

项目目标：面向高清数字电视 (HDTV) 和移动电视等应用，符合

国家相关标准的高速数字多媒体 SoC 芯片、车载移动电视 SoC 芯片、手机电视 SoC 芯片、低功耗信道解调芯片、调谐接收 RF 集成芯片等产品。“十一五”期间达到百万片级的规模应用。

组织实施方式：定向委托或择优委托。

执行期限：2009-2010 年。

项目资金与配套资金比例：1:4。

7、项目名称：高性能 IP 核开发

项目编号：017

项目目标：面向高计算密集度及移动信息终端等应用的高性能、低功耗嵌入式 DSP 及配套软硬件开发环境，在“十一五”期间形成规模应用；嵌入式高密度存储器、嵌入式可编程逻辑器件、高速高位模拟数字转换器（ADC）、数字模拟转换器（DAC）和多模、多频无线收发器等高端通用 IP 核；集成电路 IP 核设计、验证及评测技术。

组织实施方式：定向委托或择优委托

执行期限：2009-2010 年

项目资金与配套资金比例：3:2

8、项目名称：EDA 工具开发

项目编号：018

项目目标：适合我国 IC 设计产业发展需求的特色 EDA 工具，重点支持数模混合集成电路设计的 EDA 工具、成套集成电路制造成品率增长全流程工具等，在“十一五”期间推广应用。

组织实施方式：定向委托或择优委托

执行期限：2009-2010 年

项目资金与配套资金比例：3:2